

C-213钎银导体浆料

概述:

C-213 是一款无铅环保型钎银导体浆料, 用于电阻器、电位器、厚膜电路等产品的引出布线等, 产品印刷工艺适应性好, 烧结膜导电性好, 附着力好, 可焊性、耐焊性等应用性指标优良。

主要技术指标:

项 目	测试方法	技术指标
粘 度 (Pa·s)	BROOKFIELD SC4-14 10RPM, 25°C	150-270
方 阻 (mΩ/□)	测试图形60mm×0.6mm	≤5
附着力 (N)	测试图形2mm×2mm的剥离拉力	≥40
老化附着力 (N)	老化的条件为150°C, 保温24h	≥20
可焊性	测试图形2mm×2mm 浸锡覆盖率	良好
抗焊料侵蚀 (次)	230°C, 浸10秒一次	≥2

注:主要技术参数基于推荐工艺条件下实验室测试所得

推荐工艺与使用说明:

印刷丝网: 200~320目不锈钢丝网、乳胶厚度 12~20μm.

印刷基板: 96%氧化铝, 表面粗糙度2-3μm

干燥条件: 室温流平5-10 min, 100-120°C, 烘干10 min.

烧结条件: 峰值烧结温度850±5°C, 峰值时间9-11 min.

烧结膜厚: 8-12μm

粘度调整: 最好使用专用稀释剂稀释, 用量不超过1%。

储存条件: 贮藏于5-10°C冷藏柜中, 保质期6个月。

使用建议: 浆料未开封条件下充分回温, 印刷前用刮刀搅拌均匀;

产品使用场地洁净、通风良好。